

行业简讯

二〇二六年第二期

2月24日发

协会办公室编印

(总第447期)

(行业内交流)

内容提要

综合信息

- ☆ 2025年电子信息制造业运行情况

行业动态

- ☆ 2026年半导体设备大年
- ☆ 登陆科创板 知识产权成“硬科技”通关密钥
- ☆ 3月25-27日《SEMICON China 2026》在上海展出 149家会员参展

协会动态

- ☆ 中国电子专用设备工业协会完成负责人换届变更备案核准
- ☆ 中国电子专用设备工业协会章程核准
- ☆ 中国电子专用设备工业协会法人变更准予行政许可
- ☆ 3月24日在上海召开协会十届二次理事会
- ☆ 《2026年中国半导体设备核心部件选购手册》2月开始发行
- ☆ 2026年度协会会费3月份缴纳

会员动态

- ☆ 浙江晶瑞：SuperSiC 实现12英寸碳化硅 TTV $\leq 1\mu\text{m}$ 技术里程碑

- ☆ 捷佳伟创 “可实施制造+平台化验证” 双引擎，助力太空光伏快速发展
- ☆ 电科装备 45 所：斩获 5000 万订单
- ☆ 中微公司：2025 年营业收入预计同比增长 36.62%
- ☆ 盛美上海：2025 年营业收入预计同比增长 18.91% ~ 22.47%
- ☆ 华峰测控：2025 年营业收入预计同比增长 41% ~ 56%
- ☆ 芯碁微装：2025 年扣非净利润同比增长 77.70% ~ 91.16%
- ☆ 长川科技：2025 年扣非净利润同比增长 183.72% ~ 219.94%
- ☆ 凯格精机：2025 年扣非净利润同比增长 151.65% ~ 217.70%

新会员

- ☆ 上海微世半导体有限公司
- ☆ 摩登纳（中国）自动化设备有限公司
- ☆ 浙江晶瑞电子材料有限公司
- ☆ 质朋仪器贸易（上海）有限公司
- ☆ 上海大族富创得科技股份有限公司
- ☆ 机科发展科技股份有限公司
- ☆ 航天精工股份有限公司
- ☆ 苏州镁伽科技有限公司
- ☆ 莱茵技术(上海)有限公司

会员单位更名通知

综合信息

2025 年电子信息制造业运行情况

2025 年，我国电子信息制造业生产快速增长，出口同比持平，效益稳步向好，投资持续下滑，行业整体发展态势良好。

一、生产快速增长

2025 年，规模以上电子信息制造业增加值同比增长 10.6%，增速分别比同期工业、高技术制造业高 4.7%和 1.2%。

主要产品中，手机产量 15.4 亿台，同比下降 5.8%，其中智能手机产量 12.7 亿台，同比下降 0.9%；微型计算机设备产量 3.32 亿台，同比下降 2.9%；集成电路产量 4843 亿块，同比增长 10.9%。

二、出口同比持平

2025 年，规模以上电子信息制造业累计实现出口交货值同比持平。

据海关统计，我国出口笔记本电脑 1.33 亿台，同比下降 7.1%；出口手机 7.51 亿台，同比下降 7.7%；出口集成电路 3495 亿块，同比增长 17.4%。

三、效益稳步向好

2025 年，规模以上电子信息制造业实现营业收入 17.4 万亿元，同比增长 7.4%；营业成本 15.1 万亿元，同比增长 6.9%；实现利润总额 7509 亿元，同比增长 19.5%；营业收入利润率为 4.3%。

四、投资持续下滑

2025 年，电子信息制造业固定资产投资同比下降 3.8%，比同期工业投资增速低 6.4%。

五、中部地区收入增长较快

2025 年，规模以上电子信息制造业东部地区实现营业收入 122907 亿元，同比增长 7.8%；中部地区实现营业收入 30149 亿元，同比增长 11.6%；西部地区实现营业收入 20120 亿元，同比下降 0.3%；东北地区实现营业收入 876.5 亿元，同比下降 3.3%。

（来自：工信部运行监测协调局）

行业动态

2026 年 半导体设备大年

2026 年被视为半导体设备大年，核心是 AI 算力爆发、加存储扩产、加国产替代提速、加政策周期共振，四重驱动带来设备需求确定性高增。

一、AI 算力驱动先进制成与先进封装双扩展

AI 大模型与数据中心拉动高性能 GPU ASIC 需求，台积电、三星等加速 2 纳米、3 纳米先进制成扩产，单芯片设备投入显著提升，HBM 需求爆发、DRAM 投资 20% 加高增、3D NAND 持续升级，刻蚀、薄膜沉积等单机价值量先进封装扩展提速，台积电 2026 年 COWOS 产能拟提升约 80%，带动封装与测试设备需求。SEMI 预测，2026 年全球半导体制造设备销售额约 1450 亿美元，同比增长 9%。WFE 预测，2026 年全球半导体制造设备销售额约 1221 亿美元，同比增长 10.2%。

二、存储周期上行、大厂集中扩产，存储芯片进入涨价与扩展周期

WSTS 预测 2026 年全球存储市场同比增长 39.4%，带动设备采购潮。三星、SK 海力士、美光、长兴、长存等集中扩产本期共沉资本开支向设备倾斜，直接拉动存储设备需求。

三、国产替代进入加速兑现期

国内成熟制成扩产持续，12 英寸晶圆厂新建扩产超 20 座，国产设备在刻蚀、薄膜沉积、CMP 等环节替代率快速提升，中国大陆 2026 年设备支出预计达 500 亿美元，连续四年高增长，出口管制影响弱化，需求进入正常化阶段。

四、政策与产业周期共振

《十五五》规划强调供应链安全，国产设备从备选变必选，采购比例提升，库存周期向上，产能利用率回升，叠加先进工艺迭代，设备更新与新增需求共振。

五、全产业链设备需求共振

前端光刻、刻蚀、沉积等核心设备订单饱满，后端封装测试设备 2026 年分别增长 15% 和 12%，受益于先进封装渗透与 AI 芯片测试需求。

一句话总结，2026 年半导体设备是卖产人的确定性盛宴兼具强成长与国产替代弹性。

（来自：半导体设备及行业）

登陆科创板 知识产权成“硬科技”通关密钥

一、关于科创属性的专利数量

科创板上市科创属性采用“常规指标+例外条款”评价体系，例外条款要求企业核心技术相关、应用于主营业务且可产业化的发明专利合计 ≥ 50 项。参考上交所2023年半年报数据，上市公司平均拥有发明专利168项。

二、关于研发费用低的质疑

报告期内，公司与境内可比公司的研发费用与专利授权数量情况进行了列表比对，公司研发费用规模虽低于同行业可比企业，但新增发明专利授权量显著高于同行业可比公司，体现了公司具有较强的研发效能优势，可以将研发投入高效转化为科技成果。报告期内公司研发费用率显著高于同行业可比公司，其具有合理性，与公司发展阶段、研发成果匹配。

三、关于产学研合作较多

公司产学研合作全程遵循市场化原则，通过明确知识产权归属约定，保障技术独立性与合作合理性：合作过程中，已形成、未形成的专利及相关商业秘密，公司拥有独家专利申请权；未申请专利的开发成果，公司享有全部技术秘密权利；开发成果后续改进产生的新技术成果，均归公司所有，有效规避和预防知识产权纠纷，从而确保技术的独立性和合理性。

四、关于如何保证创新的持续性

公司通过“研发人员+研发项目+知识产权”协同增长，构建创新长效机制：研发人员数量与研发项目个数稳步增长且匹配合理，为创新提供人力与项目支撑；专利申请及授权数量逐年递增，与人员、项目增长形成呼应，研发创新活力充足。目前已形成“人员+项目+成果”的良性循环，有效保障创新持续性。

3月25-27日《SEMICON China 2026》在上海展出 149家会员参展

地点：上海浦东新国际博览中心 协会办公室展位设在 N4 馆 4115

中国电子专用设备工业协会专区 (CEPEA Pavilion) N4 馆 (1 门~3 门)					
序号	展商单位名称	展位号	序号	展商单位名称	展位号
1	苏州艾科瑞思智能装备股份有限公司	4000	5	苏州博宏源设备股份有限公司	4204
2	青岛华旗科技有限公司	4008	6	吉林市汇恒电子科技有限公司	4210
3	深圳格芯集成电路装备有限公司	4101	7	江苏晋誉达电子科技有限公司	4211
4	滁州美扬真空科技有限公司	4104	8	客思特设备(丹东)有限公司	4214

9	上海胤舜密封技术有限公司	4105	29	宁波尚进自动化科技有限公司	4217
10	上海集迦电子科技有限公司	4108	30	深圳市冠达宏科技有限公司	4223
11	赛英特半导体技术(西安)有限公司	4111	31	上海卓晶半导体科技有限公司	4227
12	上海嘉诺密封科技有限公司	4112	32	上海车仪田科技有限公司	4231
13	苏州晶洲装备科技有限公司	4114	33	众望赛米控(天津)科技有限公司	4235
14	无锡市沪源进出口贸易有限公司	4116	34	中国科学院光电技术研究所	4238
15	江苏雷博微电子设备有限公司	4117	35	山东力冠微电子装备有限公司	4239
16	安徽万瑞冷电科技有限公司	4118	36	上海阿法帕真空设备有限公司	4242
17	朗轩电子设备(上海)有限公司	4122	37	扬州思普尔科技有限公司	4243
18	青岛海迪克电子科技有限公司	4123	38	无锡松煜科技有限公司	4247
19	联盛半导体科技(无锡)有限公司	4127	39	青岛赛尔微电子有限公司	4310
20	苏州赫瑞特电子专用设备科技有限公司	4131	40	赛瑞达智能电子装备(无锡)有限公司	4311
21	上海蔚福真空科技有限公司	4134	41	江苏苏净集团有限公司	4315
22	青岛金立盾电子设备有限公司	4138	42	长春光华微电子设备工程中心有限公司	4323
23	中科同帆半导体(江苏)有限公司	4139	43	浙江晶瑞电子材料有限公司	4331
24	丹东辽东射线仪器有限公司	4142	44	苏州市施密科微电子设备有限公司	4339
25	丹东奥龙射线仪器有限公司	4143	45	深圳市佳迈自动化股份有限公司	4342
26	北京北仪优成真空技术有限公司	4144	46	宁波润华全芯微电子设备有限公司	4343
27	无锡奥特维科技股份有限公司	4147	47	上海车仪田科技有限公司	4344
28	浙江晶盛机电股份有限公司	4201	48	合肥真萍电子科技有限公司	4438

N1 馆

序号	展商单位名称	展位号	序号	展商单位名称	展位号
49	上海果纳半导体技术有限公司	1501	53	华海清科股份有限公司	1531
50	江苏鲁汶仪器股份有限公司	1509	54	江苏集萃苏科思科技有限公司	1541
51	西湖仪器(杭州)技术有限公司	1515	55	星奇(上海)半导体有限公司	1715
52	盛美半导体设备(上海)股份有限公司	1519			

N2 馆

序号	展商单位名称	展位号	序号	展商单位名称	展位号
56	深圳蓝动精密有限公司	2026	64	上海精测半导体技术有限公司	2423
57	广东阿达半导体设备股份有限公司	2104	65	厦门宇电自动化科技有限公司	2505
58	深圳市纳设智能装备股份有限公司	2110	66	诚联恺达(河北)科技股份有限公司	2515
59	清软微视(杭州)科技有限公司	2134	67	阿尔伯特(苏州)科技有限责任公司	2523
60	青岛思锐智能科技股份有限公司	2319	68	江阴市辉龙科技股份有限公司	2530
61	昂坤视觉(北京)科技有限公司	2325	69	康姆艾德机械设备(上海)有限公司	2551
62	江苏微导纳米科技股份有限公司	2331	70	北京京仪自动化装备技术股份有限公司	2571
63	无锡邑文微电子科技股份有限公司	2419			

N3 馆

序号	展商单位名称	展位号	序号	展商单位名称	展位号
71	合肥芯碁微电子装备股份有限公司	3118	76	北京北方华创微电子装备有限公司	3441
72	四川英杰电气股份有限公司	3201	77	中电科电子装备集团有限公司	3471
73	沈阳富创精密设备股份有限公司	3231	78	上海大族富创得科技股份有限公司	3617
74	沈阳新松半导体设备有限公司	3243	79	上海微电子装备(集团)股份有限公司	3651
75	中微半导体设备(上海)股份有限公司	3417			

N4 馆

序号	展商单位名称	展位号	序号	展商单位名称	展位号
80	绍兴宏邦电子科技有限公司	4389	82	北京华峰测控技术股份有限公司	4671
81	沈阳和研科技股份有限公司	4617			

N5 馆

序号	展商单位名称	展位号	序号	展商单位名称	展位号
83	杭州长川科技股份有限公司	5131	86	富士金阀门(上海)有限公司	5351
84	北京和崎精密科技有限公司	5189	87	杭州广立微电子股份有限公司	5543
85	北京凯德石英股份有限公司	5201			

E6 馆

序号	展商单位名称	展位号	序号	展商单位名称	展位号
88	贺利氏石英(沈阳)有限公司	6008	97	马波斯(上海)测量设备科技有限公司	6247
89	江苏先锋精密科技股份有限公司	6109	98	快克智能装备股份有限公司	6251
90	深圳市轴心自控技术有限公司	6159	99	东方晶源微电子科技(北京)股份有限公司	6263
91	翼龙半导体设备(无锡)有限公司	6163	100	中导光电设备股份有限公司	6374
92	北京华丞电子有限公司	6171	101	重庆欣晖材料技术有限公司	6382
93	无锡奥威赢科技有限公司	6173	102	深圳新益昌科技股份有限公司	6443
94	苏试宜特(上海)检测技术股份有限公司	6175	103	泓湃(苏州)半导体科技有限公司	6477
95	无锡冠亚恒温制冷技术有限公司	6227	104	大连连城数控机器股份有限公司	6501
96	飞潮(上海)新材料股份有限公司	6235	105	苏州优品半导体科技股份有限公司	6771

E7 馆

序号	展商单位名称	展位号	序号	展商单位名称	展位号
106	北京锐洁机器人科技有限公司	7014	111	深圳市腾盛精密装备股份有限公司	7369
107	芜湖通潮精密机械股份有限公司	7130	112	江苏京创先进电子科技有限公司	7463
108	嘉兴景焱智能装备技术有限公司	7239	113	苏州珂玛材料科技股份有限公司	7601
109	费斯托(中国)有限公司	7255	114	深圳市泰科思特精密工业有限公司	7667
110	拓荆科技股份有限公司	7301	115	中导光电设备股份有限公司	7729

T0 馆

序号	展商单位名称	展位号	序号	展商单位名称	展位号
116	源卓微纳科技(苏州)股份有限公司	T0136	117	沃尼克半导体科技(连云港)有限公司	T0327

T1 馆

序号	展商单位名称	展位号	序号	展商单位名称	展位号
118	杭州加速科技有限公司	T1113	122	上海熹贾精密技术有限公司	T1408
119	湖南艾科威半导体装备有限公司	T1121	123	苏州天准科技股份有限公司	T1435
120	青岛国林半导体技术有限公司	T1310	124	三河同飞制冷股份有限公司	T1447
121	上海凯世通半导体股份有限公司	T1335			

T2 馆

序号	展商单位名称	展位号	序号	展商单位名称	展位号
125	睿励科学仪器(上海)有限公司	T2143	127	无锡卓海科技股份有限公司	T2345
126	上海广川科技有限公司	T2311	128	中科九微科技股份有限公司	T2421

T3 馆

序号	展商单位名称	展位号	序号	展商单位名称	展位号
129	烟台华创智能装备有限公司	T3148	131	安泊智汇半导体设备(上海)有限公司	T3178
130	迅势科技(苏州)有限公司	T3166	132	上海隆通半导体能源科技股份有限公司	T3317

T4 馆

序号	展商单位名称	展位号	序号	展商单位名称	展位号
133	合肥三越半导体科技有限公司	T4106	142	上海亚螺精密紧固技术有限公司	T4309
134	无锡迪渊特科技有限公司	T4115	143	东莞市凯格精机股份有限公司	T4319
135	沈阳元创半导体有限公司	T4121	144	苏州普瑞斯通智能科技有限公司	T4335
136	辽宁冠华半导体有限公司	T4127	145	珠海恒格微电子装备有限公司	T4336
137	陕西易度智能科技有限公司	T4147	146	上海鹏普静电科技有限公司	T4345
138	杭州慧翔电液技术开发有限公司	T4203	147	宁波云德半导体材料有限公司	T4428
139	湖南宇晶机器股份有限公司	T4222	148	江苏特阀流体系统工程股份有限公司	T4444
140	无锡星微科技有限公司	T4243	149	苏州佰控传感技术有限公司	T4445
141	苏州中特微电子科技有限公司	T4306			

协会动态

中国电子专用设备工业协会完成负责人换届变更备案核准

2026年1月29日，民政部发【2026】2082号文《民政部关于准予中国电子专用设备工业协会负责人备案的通知书》：经审查，你单位于2025年12月10日召开的第十届第一次理事会表决通过的负责人变更事项，符合国家法规政策规定，根据《社会团体登记管理条例》等规定，通知如下：

一、卸任理事长赵晋荣，副理事长王志越、丁宁、张勇、李时俊、刘骏、郭杰，秘书长杨建忠，予以备案。

二、新一届理事长为董博宇，副理事长刘正德、朱亮、陶珩、诸祥元、冯震坤、王飞、杨超、张帆、周大良、周惟仲、王坚、王同庆，秘书长王志越，备案材料齐全，予以备案。

中国电子专用设备工业协会章程核准

1月29日，民政部发【2026】1028号文：经审查，你单位于2025年12月10日召开的第十届第一次会员代表大会表决通过的《中国电子专用设备工业协会章程》，符合国家法规政策规定，根据《社会团体登记管理条例》等规定，对你单位修改的章程予以核准，修改后的章程自核准之日起生效。

中国电子专用设备工业协会法人变更准予行政许可

1月29日，民政部发【2026】3034号文：经审查，你单位法定代表人由赵晋荣变更为王志越，符合国家法规政策规定，根据《社会团体登记管理条例》等规定，决定准予你单位法定代表人变更为王志越。

3月24日在上海召开协会十届二次理事会

根据协会十届一次理事会决议，十届二次理事会定于3月24日召开
时间：3月24日14:00~16:30（13:30~14:00报到）

地点：上海中兴和泰酒店（上海浦东新区科苑路 866 号）

酒店联系人：余鹏 手机：138 9318 2742

本次理事会议程是：

1、 审议 2025 年协会工作总结和财务决算报告；

2、 审议协会 2026 年度工作要点和财务预算；

请各位理事长、秘书长、理事准时参加。

协会联系人：裴大章 134 7236 3286

《2026 年中国半导体设备核心部件选购手册》2 月开始发行

由我协会编辑的《2026 年中国半导体设备核心部件选购手册》（以下简称：选购手册）于今年 2 月出版发送。本期《选购手册》共有 68 家核心部件会员单位投稿，全书正文 149 页，另附有 182 家核心部件会员单位名录。

本期《选购手册》共印 1000 本，需要者可通过协会微信会员群联系索取（顺丰到付），也可在今年 3 月 25 日上海举办的《SEMICON China》协会展位和 8 月 31 日在无锡举办的半导体设备年会上领取。

《选购手册》电子版已刊登在协会网站上，可点击“产品中心”栏目查看。

2026 年度协会会费 3 月份缴纳

按照协会的工作安排，协会办公室将在 3 月份办理 2026 年度会费的缴纳工作。

会费标准按 2025 年 12 月 10 日召开的第十届第一次会员代表大会上通过的会费标准办理：

理事长 10000 元；副理事长 6000 元；理事 4000 元；普通会员 2000 元。

会费票据（电子票）将通过财政部票据中心的邮箱发到会员单位联系人的电子邮箱里。

户名：中国电子专用设备工业协会

开户银行：中国工商银行北京古城支行

账号：0200014409014408028

行号：102100001442

会员动态

浙江晶瑞：SuperSiC 实现 12 英寸碳化硅 TTV $\leq 1\mu\text{m}$ 技术里程碑

近日，依托自主搭建的全流程国产化 12 英寸中试线，浙江晶盛机电股份有限公司（简称：晶盛机电）子公司浙江晶瑞电子材料有限公司（简称：浙江晶瑞）SuperSiC 成功实现 12 英寸碳化硅衬底厚度均匀性 (TTV) $\leq 1\mu\text{m}$ 的技术突破。该技术解决了碳化硅因高硬度带来的精密加工难题，满足了先进光学及封装领域对衬底面形的严苛要求。此举标志着晶盛机电“装备+材料”协同创新模式取得重大进展。目前，相关产品已实现小批量出货，公司将加速推进 12 英寸碳化硅衬底的规模化稳定量产。

（来自：晶盛机电）

捷佳伟创“可实施制造+平台化验证”双引擎，助力太空光伏快速发展

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（简称：捷佳伟创）依托“可实施制造+平台化验证”双引擎，在太空光伏领域取得关键技术突破。公司通过其“异质结+钙钛矿”中试验证平台，已成功开发出厚度仅 $50\mu\text{m}$ 的 p 型异质结电池及成熟的叠层电池工艺。

针对太空极端环境对电池“抗辐照、轻量化、高效率”的严苛要求，公司聚焦超薄异质结与钙钛矿叠层技术，在硅片减薄、抗辐射功能层沉积及全流程自动化方面实现全链条工艺覆盖。同时，公司计划打造专业的太空光伏疲劳实验室，旨在构建从关键设备研发、工艺优化到环境模拟与可靠性验证的完整闭环支撑体系，推动我国太空能源技术的自主化进程。

（来自：捷佳伟创）

电科装备 45 所：斩获 5000 万订单

中电科电子装备集团有限公司下属企业中国电子科技集团公司第四十五研究所喜迎 2026 年开门红，新签叠压机合同总额超 5000 万元。事业部团队以高效服务与专业方案赢得客户信赖，成功落地核心订单。未来将紧抓机遇，深化技术革新与市场开拓，以优质产品服务持续攻坚，力争以“开门红”引领“全年红”，为打造半导体装备领域核心力量持续奋进。

（来自：电科装备）

中微公司：2025 年营业收入预计同比增长 36.62%

1 月 24 日，中微半导体设备（上海）股份有限公司（简称：“中微公司”或“公司”）发布业绩预告，预计 2025 年营业收入约 123.85 亿元，同比增长约 36.62%；研发投入约 37.36 亿元，占营收比例达 30.16%。公司归属于母公司所有者的扣非净利润预计为 15 亿元~16 亿元，同比增长 8.06%~15.26%。

报告显示，公司在先进逻辑与存储器件刻蚀工艺方面取得重要进展，CCP、ICP 及薄膜沉积设备性能达到国际领先水平，设备覆盖率持续提升。截至 2025 年底，刻蚀设备反应台全球累计出货超过 6800 台。

（来自：中微公司）

盛美上海：2025 年营业收入预计同比增长 18.91%~22.47%

1 月 22 日，盛美半导体设备（上海）股份有限公司（简称：“盛美上海”或“公司”）发布自愿性业绩预告，初步核算 2025 年营业收入预计为 66.8 亿元~68.8 亿元，同比增长 18.91%~22.47%。公司表示，业绩增长主要得益于全球半导体行业尤其是中国大陆市场的持续增长、新客户及新市场开发成效显著，以及全球化客户拓展稳步推进。

基于当前业务趋势及在手订单情况，公司同时预计 2026 年全年营业收入将进一步增长至 82 亿元~88 亿元之间。

（来自：盛美上海）

华峰测控：2025 年营业收入预计同比增长 41%~56%

1 月 23 日，北京华峰测控技术股份有限公司（简称：“华峰测控”或“公司”）发布 2025 年业绩预告，预计实现营业收入 9.05 亿元，同比增长 41%~56%；扣非净利润预计为 3.34 亿元，同比增长 31%~62%。

业绩增长主要得益于全球半导体行业回暖、AI 及高性能计算需求爆发以及国产替代进程加速。公司通过紧抓市场机遇，发挥技术优势，重点拓展高端市场，推动了核心产品市场份额和客户覆盖度的持续提升。

（来自：华峰测控）

芯碁微装：2025 年扣非净利润同比增长 77.70%~ 91.16%

1 月 21 日，合肥芯碁微电子装备股份有限公司（简称：“芯碁微装”或“公司”）发布 2025 年业绩预告，预计实现归属于母公司所有者的扣非净利润 2.64 亿元~2.84 亿元，同比增长 77.70%~91.16%。

业绩增长主要得益于公司在高端 PCB 及泛半导体领域的持续突破。高端 LDI 设备需求旺盛，产能利用率高；高精度 CO₂激光钻孔设备已获头部客户采纳。同时，面向先进封装、板级封装的泛半导体设备陆续获得重复订单并实现交付，半导体业务正逐步放量，成为公司新的增长动力。

（来自：芯碁微装）

长川科技：2025 年扣非净利润同比增长 183.72% ~219.94%

1 月 29 日，杭州长川科技股份有限公司（简称：“长川科技”或“公司”）发布 2025 年业绩预告：2025 年年度扣非净利润 11.75 亿元~13.25 亿元，比上年同期增长 183.72% ~ 219.94%。

业绩增长得益于受行业需求复苏及客户需求旺盛驱动，公司多产品线订单增加，销售收入与利润同比大幅上升。预计非经损益约 7,500 万元，主要受并购及政府补助影响。

（来自：长川科技）

凯格精机：2025 年扣非净利润同比增长 151.65%~217.70%

1 月 31 日，东莞市凯格精机股份有限公司（简称：“凯格精机”或“公司”）扣除非经常性损益后的净利润盈利：1.60 亿元~2.02 亿元，比上年同期增长：151.65%~217.70%。

业绩增长得益于公司聚焦主业，推动产品从单一向多个“单项冠军”迈进。受益于全球电子制造业回暖、AI 投资及消费电子复苏，公司业绩稳健增长。通过技术创新、优化产品结构并聚焦高价值项目，毛利率得以提升，竞争力持续增强。

（来自：凯格精机）

新会员

上海微世半导体有限公司

会员证号：10002

法定代表人：侯金松 总经理：陈瀚

该公司是一家私有企业，公司专业从事半导体设备生产、研发与销售。主要产品有：LPCVD 低压化学相沉积系统设备等。该公司 2025 年完成销售额约 3982 万元。公司现有职工 45 人，其中技术人员 38 人。

地址：上海市奉贤区沪杭公路 755 号 邮编：201401

<http://www.micro-semi.com> E-mail: rain@micro-semi.com

电话：021-57156332 传真：021-57156323

手机：180 0640 1787、186 0176 6788

摩登纳（中国）自动化设备有限公司

会员证号：10003

法定代表人、总经理：MIGUEL ANGEL FABRA PEREZ

该公司是外商独资企业，公司专业从事自动化仓储设备的研制、生产及销售。主要产品有：MODUAL LIFT。该公司 2025 年完成销售额 3.8 亿元。公司现有职工 120 人，其中工程技术人员 40 人。

地址：江苏省(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区方洲路 7 号 邮编：215000

<http://www.modula.cn> E-mail: dunhou.liu@modula.com 手机：159 6217 3733

浙江晶瑞电子材料有限公司

会员证号：10004

法定代表人、总经理：盛永江

该公司是私有控股企业，公司专业从事半导体专用电子材料的研制、生产及销售。主要产品有：6 寸和 8 寸碳化硅片。公司现有职工 400 人，其中工程技术人员 80 人。

地址：浙江省杭州湾上虞经济开发区东二区舜园路 邮编：312300

<http://www.supersic.cc> E-mail: maozhimin@jsjd.cc 手机：139 5781 6582

质朋仪器贸易（上海）有限公司

会员证号：10005

法定代表人、总经理：汪修毅

该公司是台、港、澳商独资企业，公司专业从事半导体部件的研制、生产及销售。主要产品有：ETXI 系列/台阶仪、EC 系列/真圆度仪等。该公司 2025 年完成销售额 5000 万元。

公司现有职工 26 人，其中工程技术人员 13 人。

地址：上海市松江区新松江路 1234 号 502 室 邮编：201600

<http://www.kosaka-cn.com> E-mail: livi@kosaka-cn.com

电话：021-67826471 传真：021-6782 6471 手机：189 1651 8063

上海大族富创得科技股份有限公司

会员证号：10006

法定代表人、总经理：黄丽

该公司是私有企业，公司专业从事半导体部件的研制、生产及销售。主要产品有：标准机械界面 (SMIF)、设备前端晶圆传输及存储系统 (Sorter/EFEM/WTS/FTS)、核心零部件 (Load Port/Robot/寻边器)、真空传输 (VTM)。公司现有职工 7000 人，其中工程技术人员 300 人。

地址：上海市闵行区浦江镇万芳路 555 号 1 幢 1 层 102 室、2 层 202 室 邮编：201112

<https://www.fortrend.cn> E-mail: sundy.zhang@fortrend.com.cn

电话：021-3478 6180

机科发展科技股份有限公司

会员证号：10007

法定代表人、总经理：吴进军

该公司是中国机械科学研究总院集团的控股子公司，2023 年 11 月 30 日正式在北京证券交易所上市，是北交所第一家战配引入国家级基金的上市公司。目前公司半导体板块，专门从事于设备的研制、生产及销售。主要产品：自动减薄机和全自动减薄机。

地址：北京市海淀区首体南路 2 号 邮编：100044

<http://www.mtd.com.cn/> E-mail: 158618338@qq.com

电话：010-8830 1445 手机：186 1299 6899

航天精工股份有限公司

会员证号：10008

法定代表人：程庆文 总经理：李祥军

该公司是国有控股企业，专注于半导体设备、航空航天等战略新兴领域紧固件的研发、制造、检测及技术服务等，荣获工信部授予的全国制造业单项冠军荣誉称号。该公司 2025 年完成销售额 19.45 亿元。公司现有职工 1755 人，其中工程技术人员 939 人。

地址：天津市东丽区引航道 1 号 邮编：300300

<http://www.app.casic.cn> E-mail: market_dept_htjg@163.com

电话：022-5877 5691 手机：139 2073 0642 183 2205 2190

苏州镁伽科技有限公司

会员证号：10009

该公司是私有企业，该公司是中国机器人技术应用领域领先的自主智能体（Autonomous agents）提供商。公司专业从事半导体设备的研制、生产及销售。主要产品有：晶圆缺陷检测设备、套刻量测设备、激光加工和晶圆切割设备等。该公司现有职工 900+人，其中研发人员比例占 50%。

地址：中国（江苏）自由贸易实验区苏州片区苏州工业园区玲珑街 88 号 邮编：215001

<http://www.megarobo.com> E-mail: zengyamin@megarobo.tech

手机：178 8792 9615

莱茵技术(上海)有限公司

会员证号：10010

该公司是外商独资企业，该公司是第三方检验、检测、认证机构，可提供 SEMI、CE、北美认证等服务。该公司 2025 年完成销售额 18.06 亿元。公司现有职工 1533 人，其中技术人员占比超 60%。

地址：上海静安区广中西路 777 弄 177 号莱茵大厦 邮编：200072

<http://www.tuv.com/> E-mail: FengF.Shang@tuv.com

手机：186 2111 2842

会员单位更名通知

会员证号	原会员单位名称	更名后会员单位名称
09385	华昇时代(宁波)自动化技术有限公司	华昇时代(苏州)自动化技术有限公司
09291	上海隐冠半导体技术有限公司	上海隐冠半导体技术股份有限公司

协会办公室地址：北京市复兴路 49 号 C 座 001

电话：010-68860519

<http://www.cepea.com>

邮编：100036

传真：010-68865302

E-mail: bgs@cepea.com